证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2026-082

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：中微产业化基地建设项目
- 本次节余金额为34,208.74万元，下一步使用安排是永久补充流动资金
- 本次延期的募投项目名称：中微临港总部和研发中心项目

一、募集资金基本情况

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票
募集资金总额	820,665.87万元
募集资金净额	811,816.24万元
募集资金到账时间	2021年6月22日

中国证券监督管理委员会于2021年3月3日出具证监许可[2021]645号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准了公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票。截至2021年6月22日止，公司完成了人民币普通股A股80,229,335股的发行，每股发行价格为人民币102.29元，股款以人民币缴足，合计人民币820,665.87万元，扣除承销及保荐费用共计人民币8,206.66万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币812,459.21万元，再扣除其他发行费用人民币合计642.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币811,816.24万元（以下简称"再融资募集资金"），上述资金于2021年6月22日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2021）第0638号验资报告。

二、募投项目基本情况

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司2020年度向特定对象发行A股股票募集说明书》及《中微公司：关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》，本次募投项目情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）
中微产业化基地建设项目	317,000.00	317,000.00
中微临港总部和研发中心项目	375,000.00	375,000.00
科技储备资金	308,000.00	119,816.24
合计	1,000,000.00	811,816.24

截止2026年6月30日，2020年向特定对象公开发行股票募集资金存放及使用情况如下：

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票				
募集资金到账时间	2021年6月22日				
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日				
项目	金额				
一、募集资金总额	820,665.87				
其中：超募资金金额	–				
减：直接支付发行费用	8,849.63				
二、募集资金净额	811,816.24				
减：					
以前年度已使用金额	680,793.15				
本年度使用金额	27,932.71				
暂时补流金额	–				
现金管理金额	148,336.90				
银行手续费支出及汇兑损益	1.64				
加：					
募集资金利息收入	45,736.82				
其他	422.28				
三、报告期期末募集资金余额	910.94				

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年6月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	截止2026年6月30日余额	账户状态
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行上海分行	121910890310707	80.13	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	143.58	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	633.82	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国建设银行上海桥支行	31050161373600006133	53.40	使用中

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募集资金结项及节余情况

结项名称	中微产业化基地建设项目
结项时间	2026年8月
募集资金承诺使用金额	317,000.00万元
募集资金实际使用金额	282,791.26万元
节余募集资金金额	34,208.74万元
节余募集资金使用用途及相应金额	补流，34,208.74万元

（二）募集资金节余的主要原因

本次募集资金节余的主要原因如下：

1、募投项目建设实施期间，经公司研究和分析，优化施工工艺，有效实现资源的合理配置；

2、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持合理、节约、有效、谨慎的原则，加强项目建设各个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；

3、因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司对短期内出现的部分闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司收益。

（三）节余募集资金使用计划

结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将该项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。

四、本次募投项目延期具体情况及原因、对公司的影响

（一）本次部分募投项目延期的具体情况及原因

中微临港总部和研发中心项目原计划实施周期5年，项目计划分以下阶段实施完成，包括：前期准备、基地建设、设备购置与安装、员工招聘以及试运营。自募集资金到位以来，公司一直积极推进募投项目的实施，并根据实际情况，审慎规划资金的使用。截至本公告披露日，"中微临港总部和研发中心项目"主体建筑工程已顺利完工，部分功能楼层已完成内部装潢并可投入前期使用。为匹配后续业务扩容节奏以及研发人员分批入驻的统筹安排，剩余楼层将采取分批次装修、分阶段投用的精细化推进模式。为保障项目建成后整体运营效能与研发承载能力达到最优标准，经公司审慎评估与统筹规划，拟将该募投项目整体达到全面预定可使用状态的时间顺延至2027年12月。

（二）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，谨慎管理和使用募集资金，截至本公告披露日，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。

（三）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，并持续关注影响项目推进的各项因素，充分结合行业发展情况，科学合理决策，确保募集资金依法合规、高效使用。公司将加强对募集资金使用全过程的监督与管理，推动募投项目按期完成。

（四）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、适用的审议程序及保荐人意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将2020年向特定对象公开发行股票募投项目"中微产业化基地建设项目"结项，并将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动；同意将募投项目"中微临港总部和研发中心项目"预定可使用状态的日期延期至2027年12月。本次事项无需提交股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次2020年向特定对象公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

综上，保荐人对公司2020年向特定对象公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2026-079

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币6,004.51万元。本次募集资金置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147号）核准，同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份募集配套资金不超过15亿元的注册申请。

公司本次募集配套资金发行人民币普通股（A股）5,156,765股，每股发行价为人民币290.88元，募集资金总额为人民币1,499,999,803.20元，扣除本次发行费用人民币10,118,562.20元，实际募集资金净额为人民币1,489,881,241.00元。上述资金到位情况已经由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2026）第0016号）。公司已开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、独立财务顾问签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司本次向不超过三十五名特定对象发行股份募集资金总额不超过150,000万元，具体投入项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	占募集配套资金比例
1	高端半导体设备产业化项目	38,338.89	25.56%
2	高端半导体设备研发中心项目	34,702.57	23.14%
3	支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	4.64%
4	补充流动资金	70,000.00	46.67%
合计		150,000.00	100.00%

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募投项目"发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金"的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至2026年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,004.51万元，本次拟使用募集资金置换预先投入金额为人民币6,004.51万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额	需置换金额
支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	6,004.51	6,004.51

上述事项已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中微半导体设备（上海）股份有限公司截至2026年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2026)第0892号）鉴证。

四、本次募集资金置换的审议程序

公司于2026年8月19日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用共计6,004.51万元的募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。该事项无需通过股东会审议。

本次募集资金置换时间未超过募集资金到账后6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所鉴证意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中微半导体设备（上海）股份有限公司截至2026年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2026)第0892号），认为：上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用报告在所有重大方面如实反映了中微公司截至2026年7月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（二）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已履行了必要的审议程序，会计师事务所出具了专项鉴证报告，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。

综上所述，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2026年8月20日

证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2026-077

中微半导体设备（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2026年半年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月1日签发的证监许可[2019]1168号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，中微半导体设备（上海）股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股53,486,224股，每股发行价格为人民币29.01元，股款以人民币缴足，计人民币155,163.54万元，扣除承销及保荐费用共计人民币8,782.84万元后，实际收到募集资金计人民币146,380.69万元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计1,810.41万元后，实际募集资金净额为人民币144,570.28万元（以下简称"首发募集资金"），上述资金于2019年7月16日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2019）第0411号验资报告。

2、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金

中国证券监督管理委员会于2021年3月3日出具证监许可[2021]645号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准了公司向特定对象发行80,229,335股人民币普通股A股股票。截至2021年6月22日止，公司完成了人民币普通股A股80,229,335股的发行，每股发行价格为人民币102.29元，股款以人民币缴足，合计人民币820,665.87万元，扣除承销及保荐费用共计人民币8,206.66万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币812,459.21万元，再扣除其他发行费用人民币合计642.96万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币811,816.24万元（以下简称"再融资募集资金"），上述资金于2021年6月22日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2021）第0638号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金

中国证券监督管理委员会于2026年5月11日出具证监许可[2026]1147号文《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准了公司向特定对象发行5,156,765股人民币普通股A股股票。截至2026年6月17日止，公司完成了人民币普通股A股5,156,765股的发行，每股发行价格为人民币290.88元，股款以人民币缴足，合计人民币149,999.98万元，扣除承销及保荐费用共计人民币954.00万元（不含增值税）后，实际收到募集资金计人民币149,045.98万元，再扣除其他发行费用人民币合计57.86万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币148,988.12万元（以下简称"配套募集资金"），上述资金于2026年6月17日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2026）第0016号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2019年7月16日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	155,163.54
其中：超募资金金额	44,570.28
减：直接支付发行费用	10,593.26
二、募集资金净额	144,570.28
减：	
以前年度已使用金额	130,061.20
本年度使用金额	–
暂时补流金额	–
现金管理金额	18,991.95
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
募投项目结项资金转出	4,425.06
增值税税金	620.00
加：	
募集资金利息收入	9,548.75
其他	
三、报告期期末募集资金余额	20.24

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年6月22日			
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日			
项目	金额			
一、募集资金总额	820,665.87			
其中：超募资金金额	–			
减：直接支付发行费用	8,849.63			
二、募集资金净额	811,816.24			
减：				
以前年度已使用金额	680,793.15			
本年度使用金额	27,932.71			
暂时补流金额	–			
现金管理金额	148,336.90			
银行手续费支出及汇兑损益	1.64			
加：				
募集资金利息收入	45,736.82			
其他	422.28			
三、报告期期末募集资金余额	910.94			

单位：万元　币种：人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2026年6月17日			
本次报告期	2026年6月17日至2026年6月30日			
项目	金额			
一、募集资金总额	149,999.98			
其中：超募资金金额	–			
减：直接支付发行费用	1,011.86			
二、募集资金净额	148,988.12			
减：				
以前年度已使用金额	–			
本年度使用金额	954.00			
暂时补流金额	–			
现金管理金额	–			
银行手续费支出及汇兑损益	–			
加：				
募集资金利息收入	–			
其他	1,011.86			
三、报告期期末募集资金余额	149,045.98			

二、募集资金管理情况

中微公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《中微公司：募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2019年7月16日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600004844	20.24	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行上海金桥支行	121910890310602	–	已注销
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201014101024127	–	已注销

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年6月22日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行上海分行	121910890310707	80.13	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行	8110201013601303837	143.58	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海浦东发展银行张江科技支行	97160078801900002862	633.82	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国建设银行上海金桥支行	31050161373600006133	53.40	使用中

单位：万元　币种：人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2026年6月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中微半导体设备（上海）股份有限公司	国家开发银行上海分行	310001900000000100378	38,338.89	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000011938	76,004.51	使用中
中微半导体设备（上海）股份有限公司	平安银行上海分行营业部	15001217560061	34,702.57	使用中

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年8月28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司作为实施主体在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换。本报告期公司募投项目先期投入及置换情况见下表：

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票			
募集资金到账时间	2021年6月22日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
中微产业化基地建设项目	317,000.00	–	–	不适用	2025年8月28日
中微临港总部和研发中心项目	375,000.00	10,999.13	10,999.13	2026年	2025年8月28日
科技储备资金	119,816.24	–	–	不适用	2025年8月28日

单位：万元　币种：人民币

发行名称	发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2026年6月17日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
高端半导体设备产业化项目	38,338.89	–	–	不适用	2026年8月19日
高端半导体设备研发中心项目	34,702.57	–	–	不适用	2026年8月19日
支付现金对价及中介机构费用	6,958.53	6,004.51	–	不适用	2026年8月19日
补充流动资金	70,000.00	–	–	不适用	2026年8月19日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过180,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效，在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
180,000	安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品	2026年4月28日	2027年4月27日	2026年3月30日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票									
募集资金到账时间	2019年7月16日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	11/11/2025	2/9/2026	2/9/2026	0.00	1.65%	77.67
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	3/12/2026	6/10/2026	6/10/2026	0.00	1.65%	73.23
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司上海分行	协定存款	协定存款	18,991.95	7/16/2025	7/15/2026	不适用	18,991.95	0.53%	13.40

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年向特定对象公开发行股票									
募集资金到账时间	2021年6月22日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中微半导体设备（上海）股份有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	七天通知存款	七天通知存款	16,949.47	无固定期限	无固定期限	不适用	16,949.47	1.55%	529.91
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	七天通知存款	七天通知存款	24,363.75	无固定期限	无固定期限	不适用	24,363.75	1.95%	
南昌中微半导体设备有限公司	招商银行股份有限公司南昌高新支行	协定存款	协定存款	361.51	无固定期限	无固定期限	不适用	361.51	1.50%	0.20
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	七天通知存款	七天通知存款	4,000.00	无固定期限	无固定期限	不适用	4,000.00	1.35%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市浦东分行	协定存款	协定存款	1,997.01	无固定期限	无固定期限	不适用	1,997.01	0.35%	3.36
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国进出口银行上海分行	协定存款	协定存款	353.48	无固定期限	无固定期限	不适用	353.48	0.45%	0.70
中微半导体设备（上海）股份有限公司	国家开发银行股份有限公司上海市分行	协定存款	协定存款	1,801.13	无固定期限	无固定期限	不适用	1,801.13	0.45%	3.35
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行	协定存款	协定存款	21,188.63	无固定期限	无固定期限	不适用	21,188.63	0.35%	39.64
中微半导体设备（上海）股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	协定存款	16,554.38	无固定期限	无固定期限	不适用	16,554.38	0.45%	37.81
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海长宁支行	协定存款	协定存款	1,347.46	无固定期限	无固定期限	不适用	1,347.46	0.45%	0.34
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行	协定存款	协定存款	10,419.83	无固定期限	无固定期限	不适用	10,419.83	0.35%	18.41
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海隆昌支行	协定存款	协定存款	3,618.15	无固定期限	无固定期限	不适用	3,618.15	0.45%	8.27
中微半导体设备（上海）股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海人民广场支行	协定存款	协定存款	143.67	无固定期限	无固定期限	不适用	143.67	0.45%	0.23
中微半导体设备（上海）股份有限公司	上海银行股份有限公司张江支行	协定存款	协定存款	238.45	无固定期限	无固定期限	不适用	238.45	0.53%	0.52
中微半导体设备（上海）股份有限公司	光大银行隆昌支行	七天通知存款	七天通知存款	7,000.00	无固定期限	无固定期限	不适用	7,000.00	0.75%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	光大银行隆昌支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	12/31/2025	3/31/2026	3/31/2026		1.65%	33.00
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	1/1/2026	1/30/2026	1/30/2026		1.70%	27.01
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2/1/2026	2/28/2026	2/28/2026		1.70%	25.15
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/1/2026	3/31/2026	3/31/2026		1.62%	14.14
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/1/2026	5/29/2026	5/29/2026		1.60%	41.45
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	4/1/2026	4/30/2026	4/30/2026		1.70%	13.51
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	5/1/2026	5/29/2026	5/29/2026		1.65%	12.66
中微半导体设备（上海）股份有限公司	中信银行上海浦东分行营业部	结构性存款	结构性存款	20,000.00	6/3/2026	9/3/2026	不适用	20,000.00	1.65%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	1/6/2026	1/30/2026	1/30/2026		1.54%	10.13
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2/2/2026	2/27/2026	2/27/2026		1.55%	10.62
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	3/3/2026	3/31/2026	3/31/2026		1.60%	12.27
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	4/7/2026	4/30/2026	4/30/2026		1.62%	9.01
中微半导体设备（上海）股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	结构性存款	10,000.00	6/3/2026	9/1/2026	不适用	10,000.00	1.50%	
中微半导体设备（上海）股份有限公司	光大银行隆昌支行	结构性存款	结构性存款	8,000.00	4/1/2026	7/1/2026	不适用	8,000.00	1.60%	

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将再融资募集资金中微产业化基地建设项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。

（七）募集资金使用的其他情况

本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期公司募集资金投资项目不存在变更、对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股票																
募集资金到账日期	2019年7月16日																
本年度投入募集资金总额	–																
已累计投入募集资金总额	130,061.20																
变更用途的募集资金总额	–																
变更用途的募集资金总额比例	–																
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已更目，部变（如有）	变项目，含分更如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本度现效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	目行是发重变化		
高端半导体设备产业化项目	生产建设	无		38,338.89	38,338.89	38,338.89	–	–	–38,338.89	–	不适用	不适用	不适用	否			
高端半导体设备研发中心项目	研发项目	无		34,702.57	34,702.57	34,702.57	–	–	–34,702.57	–	不适用	不适用	不适用	否			
支付现金对价及中介机构费用	现金对价、中介费用	无		6,958.53	6,958.53	6,958.53	954.00	954.00	–6,004.53	13.71%	不适用	不适用	不适用	否			
补充流动资金	补充流动资金	无		70,000.00	70,000.00